

苏州晶方半导体科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2019年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]50号《关于核准苏州晶方半导体科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2014年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）56,674,239股，其中发行新股人民币普通股37,196,955股，老股转让数量为19,477,284股，每股发行价格为人民币19.16元，新股募集资金及老股转让所得资金总额人民币1,085,878,419.24元，扣除发行费用人民币69,074,393.80元，实际新股募集资金及老股转让所得净额为人民币1,016,804,025.44元，其中新股募集资金净额667,358,119.77元，老股转让所得净额349,445,905.67元。上述资金已于2014年1月28日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]0268号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2014年2月24日，公司与保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求。

（三）募集资金的结余情况

截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32201988836051528556	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截止 2019 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2014 年 2 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 49,761.87 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 49,761.87 万元；（2）直接投入募集资金项目 17,228.65 万元。截至 2019 年 9 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 66,990.52 万元，其中包括募集资金专用账户利息收入扣除手续费后净额 254.71 万元。募集资金专户 2019 年 9 月 30 日余额为 0.00 万元。

本公司承诺投资项目为：先进晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）技改项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截止 2019 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

募集资金项目的实际投资总额 66,990.52 万元，超出承诺投资金额 254.71 万元，系募集资金专户使用期间产生的利息收入 254.71 万元。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截止 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截止 2019 年 9 月 30 日，公司不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截止 2019 年 9 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(三) 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

前次募投项目的主要应用领域为以手机为代表的消费电子行业，近几年全球智能手机市场趋于饱和、销量增速逐年放缓，消费电子领域市场环境由以往的增量市场转变为存量市场，行业整体需求疲软，业务与市场竞争激烈程度不断上升，导致前次募投项目的产品销量未及预期且市场销售价格有所下降，故累计实现的收益低于承诺的累计收益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日止，通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，确认前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2019 年 12 月 26 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位: 苏州晶方半导体科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 66,735.81		已累计使用募集资金总额: 66,990.52								
变更用途的募集资金总额: 无		各年度使用募集资金总额: 66,990.52								
变更用途的募集资金总额比例: 无		2014 年: 66,990.52								
		2015 年: 0.00								
		2016 年: 0.00								
		2017 年: 0.00								
		2018 年: 0.00								
		2019 年 1-9 月: 0.00								
投资项目		截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额*1	募集后承诺投资金额	实际投资金额		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额*2	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	先进晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 技改项目	先进晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 技改项目	66,735.81	66,735.81	66,990.52	66,735.81	66,735.81	66,990.52	254.71	2014-12-31

*1: 招股说明书中承诺投资金额为 66,735.96 万元, 实际募集资金为 66,735.81 万元。

*2: 募集资金项目的实际投资总额 66,990.52 万元, 超出承诺投资金额 254.71 万元, 系募集资金专户使用期间产生的利息收入 254.71 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2019 年 9 月 30 日

编制单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 项目利用率	承诺效益 (年均净利 润)	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益*2	是否达 到预计 效益
				2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 1-9 月*1		
1	先进晶圆级芯片尺 寸封装 (WLCSP) 技改项目	84.14%	18,237.00	8,974.51	11,069.54	9,462.09	7,899.24	54,813.53	否

*1: 2019 年 1-9 月份实际效益未经审计。

*2: 累计实现效益包括 2014 年及 2015 年度前实现的效益分别为 9,195.73 万元、8,212.42 万元。